

「SEMICON Japan 2024 / APCS 2024」出展のご案内

拝 啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスグループは、12月11日（水）～13日（金）、東京ビッグサイトで開催される

『SEMICON Japan 2024 / APCS (Advanced Packaging and Chiplet Summit) 2024』に出展いたします。

是非この機会に、芝浦メカトロニクスグループの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げます。

敬 具

－ 記 －

日 時 : 2024年12月11日（水）～13日（金） 10:00～17:00

会 場 : 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟

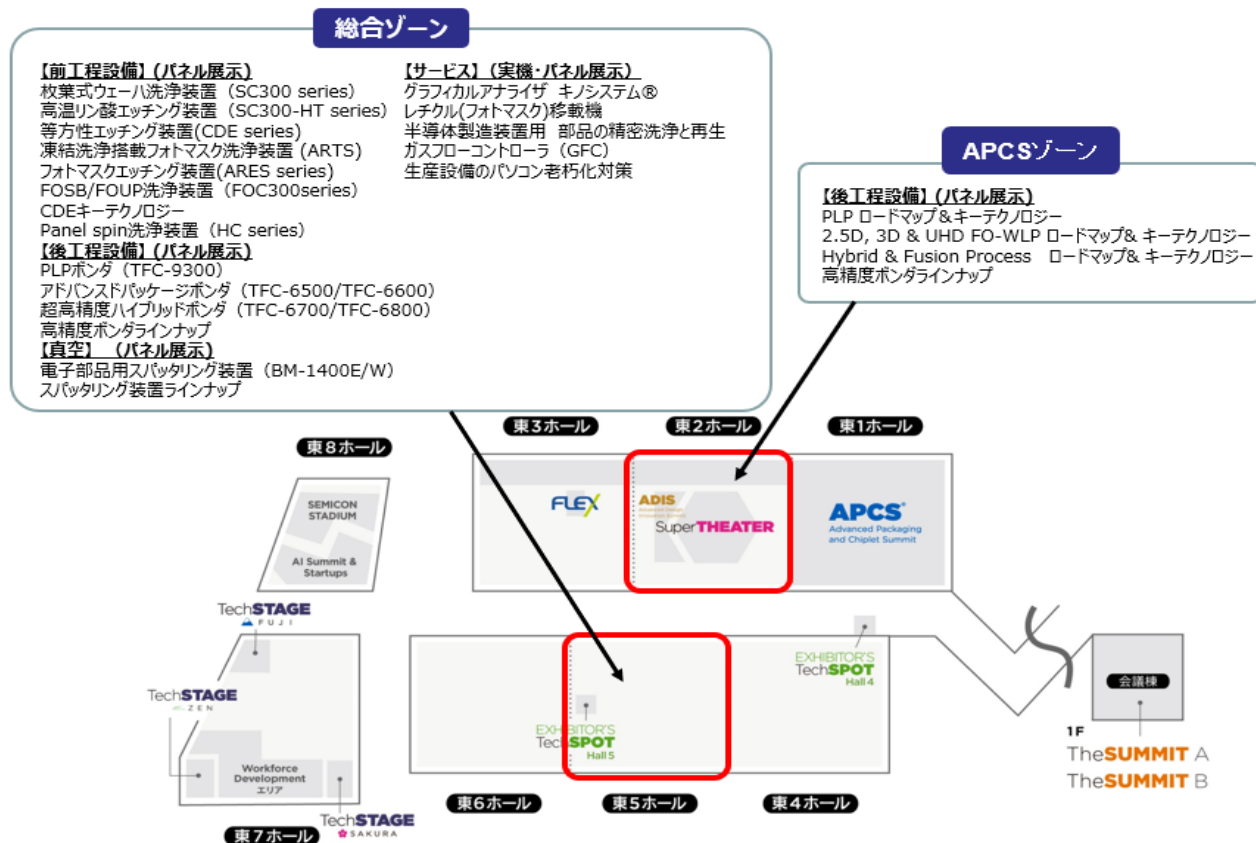
展示ブース : ①総合ゾーン 東展示棟 Hall5 小間番号 5621

②APCSゾーン 東展示棟 Hall2 小間番号 2249

Web サイト : <https://www.semiconjapan.org/jp/>

出展品目 :

SEMICON[®] JAPAN
APCS Advanced Packaging
and Chiplet Summit



以 上

【ご注意】

ご来場の際は、展示会 Web サイトから事前登録していただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

芝浦エレクトック株式会社 経営企画部 企画担当

e-mail : esc@shibaura.co.jp

web サイト : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>

